

سامانه زدایش بازفعال یونی

RIE (Reactive Ion Etching) System

یکی از روش‌های زدایش خشک که به طور گسترده‌ای در تکنولوژی ساخت قطعات نیمه‌هادی و ابررسانا به کار می‌رود، روش *RIE* است. این روش ترکیبی از زدایش فیزیکی و شیمیایی است. از محاسن این روش می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

◦ ناهمسانگرد و انتخابی بودن زدایش نسبت به روش‌های شیمیایی (*Wet Etching*)

◦ بالاتر بودن سرعت زدایش نسبت به روش زدایش با پلاسما (*Plasma Etching*)

*مشخصات فنی:

◦ دارای مولد فرکانس رادیویی (*RF Generator*) با توان ۲۰۰ وات

◦ قابلیت تنظیم دقیق فلوئی گاز توسط *MFC* و شیرهای سوزنی

◦ محفظه استوانه‌ای استیل با قطر ۲۷۰ mm و ارتفاع ۱۰۰ mm

◦ بخش تخلیه شامل پمپ روتاری و پمپ توربومولکولی

◦ کنترل شونده با *PLC* به صورت نیمه/تمام اتوماتیک

◦ دارای فیلترهای مناسب برای روغن و گازهای سمی

◦ دارای پخت کننده یکنواخت گاز در محفظه

◦ امکان نصب نمونه با قطر بیشینه ۳ اینچ

◦ مناسب برای زدایش لایه‌های نانومتری

◦ فشار پایه: $\times 10^{-9}$ torr

کارخانه معمولان این شرکت در ایام ۱۷ ماه گذشته می‌باشد.

